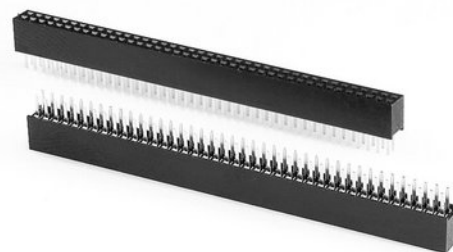


## Buchsenleisten RM 1,27mm - 2-reihig - BH 3,4mm / 4,3mm

Female Header Strips - Pitch 1,27mm - Double Row - Height 3,4mm / 4,3mm

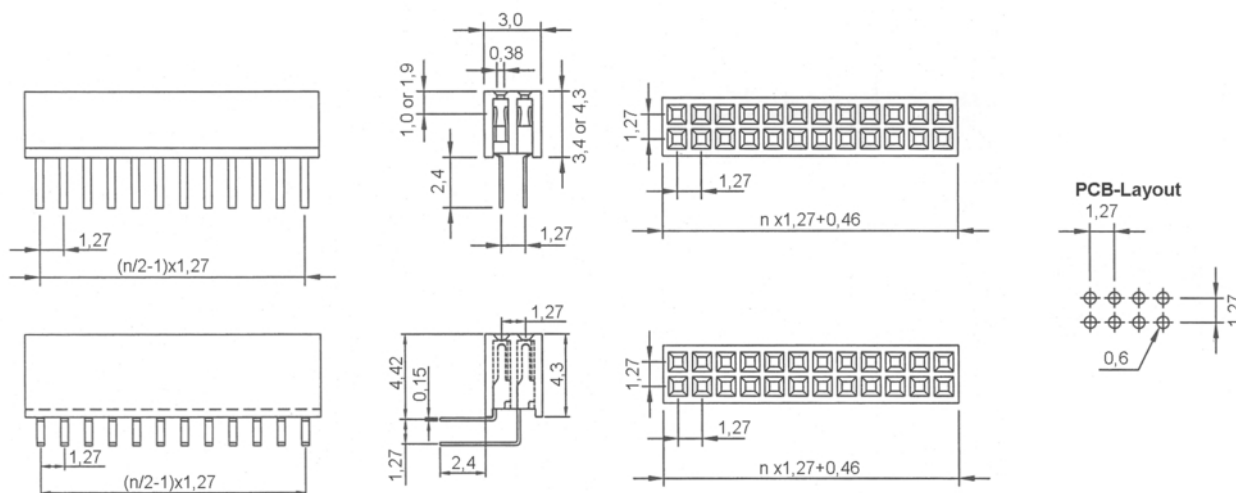
### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1,3 ... 2,5µm)
Lötbarkeit	IEC512-12A
Solderability	IEC512-12A
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 10 <sup>9</sup> Ω
Insulation Resistance	> 10 <sup>9</sup> Ω
Spannungsfestigkeit	500V <sub>AC</sub>
Test Voltage	500V <sub>AC</sub>
Nennstrom	1A
Current Rating	1A
Temperaturbereich	-40°C ... +105°C
Temperature Range	-40°C ... +105°C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren; weitere Informationen in Kapitel T
Processing	Reflow-soldering, detailed information in ch. T



© W+P PRODUCTS

Einsetzbar für Vierkantstift 0,40mm  
Accepts square pin 0,40mm



Series	Contacts*	Type*	Height*	Plating
<b>605</b>	<b>100</b> 006-100 Zweireihig Double row	<b>2</b> 1 Gerade Straight 2 Gewinkelt (nur Bauhöhe 4,3mm) Right angled (only available with height 4,3mm)	<b>2</b> 1 Bauhöhe 3,4mm Height 3,4mm 2 Bauhöhe 4,3mm Height 4,3mm	<b>50</b> 00 Vergoldet Gold plated 50 Verzinnt Tin plated

(\* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.

\* Order example - To be replaced by your specifications.)

TEL.: +49 5223 98507-0  
FAX.: +49 5223 98507-50

**W+P PRODUCTS**

E-MAIL: sales@wpro.com  
INTERNET: www.wpro.com

# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow-Soldering Information

### Reflow-Lötverfahren Reflow-Soldering

Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflowverfahren verarbeitet werden (Maximalwerte)

Profil Eigenschaft	Bleifreies Löten
Durchschnitts-Ramp-Up Rate ( $T_{S_{max}}$ to $T_p$ )	3°C / Sek. Max.
Vorheizen - Temperatur Min ( $T_{S_{min}}$ ) - Temperatur Max ( $T_{S_{max}}$ ) - Zeit ( $t_{S_{min}}$ auf $t_{S_{max}}$ )	150°C 200°C 60-180 Sekunden
Verbleiben oberhalb: - Temperatur ( $T_L$ ) - Zeit ( $t_L$ )	217°C 60-180 Sekunden
Peak/Klassifizierung Temperatur ( $T_p$ )	260°C +/- 5°C
Zeit innerhalb von 5°C um die Peak-Temperatur ( $t_p$ )	20-40 Sekunden
Ramp-Down Rate	6°C / Sekunde max.
Zeit von 25°C bis zur Peak-Temperatur	8 Minuten max.

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature-profile for leadfree reflow-soldering (maximum values):

Profile Feature	PB-Free assembly
Average Ramp-Up Rate ( $T_{S_{max}}$ to $T_p$ )	3°C / second max.
Preheat - Temperature Min ( $T_{S_{min}}$ ) - Temperature Max ( $T_{S_{max}}$ ) - Time ( $t_{S_{min}}$ auf $t_{S_{max}}$ )	150°C 200°C 60-180 seconds
Time maintained above: - Temperature ( $T_L$ ) - Time ( $t_L$ )	217°C 60-180 seconds
Peak/Classification Temperature ( $T_p$ )	260°C +/- 5°C
Time within 5°C of actual Peak-Temperature ( $t_p$ )	20-40 seconds
Ramp-Down Rate	6°C / second max.
Time 25°C to Peak Temperature	8 minutes max.

Empfohlenes Reflow-Lötprofil:

Recommended Reflow-Soldering profile:

